

院所系組		智慧機電學院 機械工程系碩士班		
招生分組		甲組 (設計與製造組)	乙組 (機光電與控制組)	丙組 (材料與能源組)
一般生名額		11	10	9
研究領域		精密機械設計、機構設計、最佳化設計、電腦輔助設計與工程分析、衝擊與破壞力學、生物力學、機器人、智權管理、機械視覺、虛擬實境、微系統設計與製造、智慧製造、精密製造與量測、3D 列印、精微加工、微細加工、塑性加工、雷射加工、網際網路於遠距加工之應用、CAD/CAM、太陽能電池與光電感測元件、微機電系統技術、隨機振動、系統識別、模態分析、逆向工程等。	機光電整合、工業 4.0、自動化技術、控制理論、電機機械、馬達設計、超音波馬達、壓電材料應用、光學系統設計量測、投影機顯示技術、微機電系統、微感測器、磁感測、電磁分析、永磁磁石製作、非破壞檢測等。	微奈米製程與檢測技術、材料工程應用、電子材料、射出成形、微成形、機械熱流、微流體、能源科技(太陽能、燃料電池、氫能)、場發射元件、電子散熱、高分子加工及流變應用、非傳統加工、感測技術應用、智慧成型技術等。
考科	時間	考試科目	配分率(%)	同分參酌順序
考科一	-	【書面資料】	50%	2
考科二	網路公告	【面試】	50%	1
成績計算		總成績=考科一書面資料成績 x50%+考科二面試成績 x50% (評分至小數點第二位)		
書面資料審查上傳文件項目		<ol style="list-style-type: none"> 1.大專案校歷年成績單(成績單須加蓋學校章戳,若符合提前畢業者,須在歷年成績單註明:「該生符合畢業標準」)。 2.師長或工作單位主管推薦函 2 封。(線上推薦函) 3.學習及研究計畫。 4.其他有助於審查之相關能力證明,如:專題報告、著作、證照、英檢證書、競賽得獎證明及研究所能力考試證明等。 		
備註		<ol style="list-style-type: none"> 1.本系不招收入學大學同等學力第 7 條「專業領域表現具卓越成就者」。 2.訂於 114 年 3 月 8 日(六)辦理面試,報名時限填高雄考區。 3.上課地點:建工校區 		
系所聯絡方式		07-3814526 轉 15319 施先生。		